

均温板 Vapor Chamber

产品特性 Features

- 二维面传导
Two-dimentional heat transfer
- 被动元件
Passive component
- 高稳定性
High stability
- 较热管高十倍性能
10 times efficiency higher than heat pipe

产品应用端 Application:

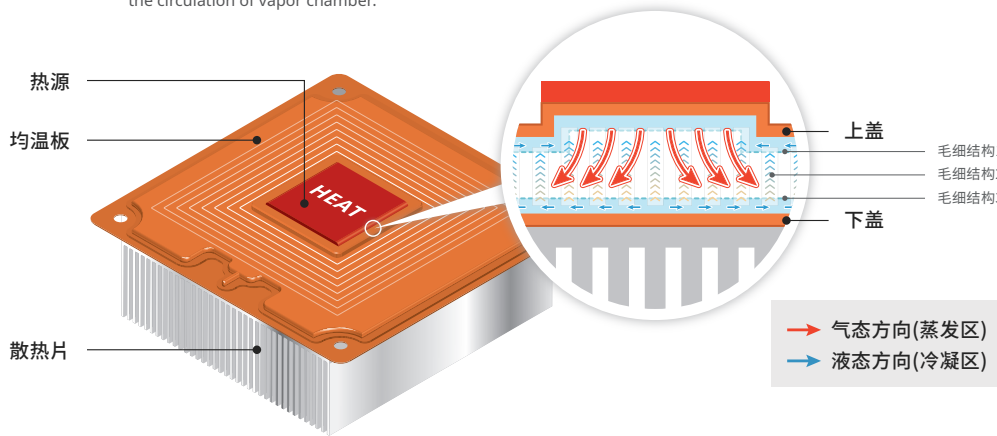
极适用于高效能散热应用 Best for high performance applications

电子元件 Electronic components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datalog, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

散热机制 Mechanism

均温板是二维热传方式，可以解决更严苛与高效率的散热问题。内部有毛细结构的真空封闭腔体，工作流体吸收热量后迅速汽化，并往冷凝区移动，经热交换后凝结成液态回流，周而复始的循环。

Vapor chamber is two-dimensional thermal conduction. Therefore, it is a more efficient heat dissipation way for solve higher level thermal problem. The inside of vapor chamber is a capillary structure vacuum chamber. After the working fluid absorbs the heat, it will vaporize rapidly and flow to cooling zone. When it exchanged heat with the external, it will condense back to fluid and flow back to heat zone. This is the circulation of vapor chamber.



专案流程 Project process

选择指南 Design Guide

※ 热源大小 Heat Size 30X30 mm

- Step 1 提供需求**
顾客由网站提供需求
专业产品顾问将与您接洽
- Step 2 专案讨论**
产品机构条件
相关需求确认
- Step 3 提供对策**
产品顾问提供
热处理对策
- Step 4 进度追踪**
方便顾客追踪流程
以准时达成目标

Size (mm)	Q-Max			Thickness (mm)		
	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0
60X80	50	70	90			
90X90	80	120	160			
100X100	140	200	260			
120X80	130	200	250			
180X150	160	250	300			
200X120	200	300	400			
350X100	220	350	450			

高柏科技团队提供订制设计。如有产品需求请联络我们

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan

T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19
20230721



注意：本技术数据表内的资讯是根据高柏团队的研究与测试得出的最佳数据。本技术数据表中列出的值仅代表典型值，并非对每一批生产的物料都进行测试。所有规格如有变更，恕不另行通知；无影响产品功能之保护膜及离型纸，如非特殊要求，皆依高柏默认为准。由于各种可能的使用条件超出了我们的控制范围，因此我们提出的所有建议均不构成保证或责任，用户应自行进行测试，以确定我们的产品在任何特定情况下的适用性。本产品的销售没有任何明示或暗示的说明，表示其适用于特定目的或其他用途的保证，但本产品应依据高柏与您确认的发票、报价、或订单，提供最标准的产品质量。我们不承担使用者如何延伸或改变此技术数据表中的资讯，使用者应承担所有风险。此外，本技术数据表中的资讯不包含任何内容解释与涉及产品材料的现有用途、未来专利冲突、工艺制造，与使用产品的建议。